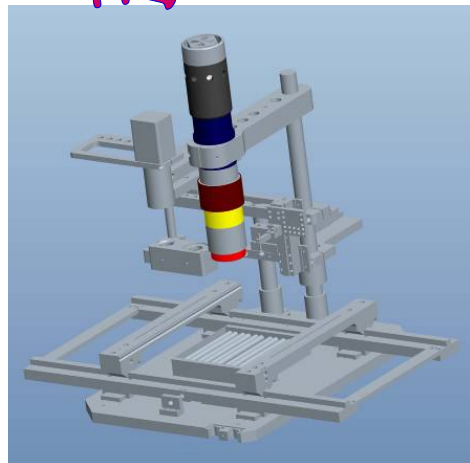




99% BGA 更換成功率

Chip_Nname	Ball Size	Successfully
PCH BD82H57 SLGZL	0.4mm	99%
PCH BD82Q65 SLJ4E	0.4mm	99%
PCH BD82Q77 SLJ83	0.4mm	99%
PCH DH82Q87 SR173	0.4mm	99%
PCH GL82H110 SR2CA	0.3mm	99%



專業技術+專業機器解決您的問題.

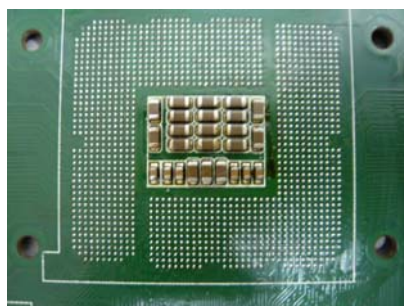
1. 紅外線輻射傳遞熱能，沒有外力造成零件位移問題。
2. 紅外線輻射加熱，230°C即可拆下南橋。
3. 紅外線輻射加熱，不易造成變色及板彎。

IR-600 紅外線 BGA 晶片拆錫機優點

	IR-600 紅外線加熱
NH82801GB 芯片拆錫溫度	230°C
高溫 LGA1366 CPU 座	260°C 成功率>99%
加熱銲接造成板彎	不易
加熱造成零件移動	不會
加熱造成零件壞損	不易
南橋芯片銲接成功率	99%
加熱耗電量	低



Socket1366 拆料



View Socket1366



Socket1366 mount

讓利佳竭誠為您服務